



Soitec a émis 2 250 000 ABSAAR dans le cadre du PACEO(1)

Bernin, France, le 16 juin 2008 - Soitec, le leader du matériau SOI (Silicium sur Isolant), annonce la création de 2 250 000 ABSAAR(2) dans le cadre de son programme PACEO approuvé par les Actionnaires lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2007 et mis en place le 5 juin 2008 avec Société Générale.

Les ABSAAR ont été émises au prix de 5,3 euros et représentent 2,72% du capital social.

La motivation principale de cette émission est d'associer l'ensemble des salariés et mandataires sociaux, en France et à l'international, au développement de Soitec dans le cadre du plan d'intéressement de la Société, qui n'est plus éligible aux BSPCE(3).

C'est donc en remplacement des anciens programmes de BSPCE que les salariés et mandataires sociaux du groupe auront la possibilité exclusive, notamment à travers le plan d'épargne entreprise, d'acquérir les BSAAR(4), détachés des ABSAAR, à la valeur déterminée par un expert indépendant. Les BSAAR et/ou les actions obtenues par exercice des BSAAR seront incessibles pendant les deux premières années(5).

La Société rappelle que la dilution maximale liée à la mise en œuvre du PACEO restera inférieure à 10% du capital, conformément à l'autorisation des actionnaires, et dépendra de l'utilisation réelle du PACEO sur les 4 prochaines années. La Société dispose en outre d'un programme de rachat d'actions qui pourra lui permettre de maîtriser la dilution pour ses Actionnaires.

Soitec précise également que ses perspectives à court terme restent inchangées et que la présente levée de fonds, d'environ 11,9 millions d'euros, ne répond donc pas à un besoin spécifique de

(1) PACEO - Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options

(2) ABSAAR - Action à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables

(3) BSPCE - Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

(4) BSAAR - Bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables, non cotés

(5) Hors cas de déblocage anticipé dans le PEE

ressources financières, la Société rappelant qu'elle disposait de 187 millions d'euros de disponibilités au 31 mars 2008.

A PROPOS DE PACEO

PACEO (Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) est une solution de financement en fonds propres créée par Société Générale. PACEO apporte aux sociétés de croissance un moyen de financement optionnel et complémentaire et peut être associé à des plans d'intéressement salariaux. Il procure le même résultat économique et financier qu'une augmentation de capital tout en offrant une flexibilité comparable à celle d'une ligne de crédit confirmée. Le prix d'émission des actions à chaque tirage reflète le cours de bourse du moment. Le programme est utilisé uniquement à la demande de l'émetteur. La Société Générale a déjà mis en place de nombreuses opérations PACEO en France et dans le reste de l'Europe, en couvrant différents secteurs d'activité.

A PROPOS DE SOITEC

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris.

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

CONTACTS

SOITEC

Olivier Brice

Tel : +33 4 76 92 93 80

olivier.brice@soitec.fr

* * *